



盛帆半导体(苏州) 有限公司 企业简介

SFA Semicon (Suzhou) Co.,Ltd

SFA :Solution For Advancement

SFA 에스에프에이

客户至上 争做主人 行事如电

集团介绍 - SFA반도체 Group

总部/工厂

销售、服务站

韩国 (总部-SSK)

- IC 封装及测试
- 储存卡
- 研发中心
- 1998年6月成立

欧洲

日本

中国台湾

博伊西

圣何塞

尔湾市

- IC 封装及测试
- 2004年3月成立

中国 (SSC)

- IC 封装及测试
- 模块、测试
- 2011年2月成立

菲律宾 (SSP)

公司概况 - SSK회사



Plant Information

- **Location** : Cheonan, South Korea
- **Building 1** : Package Assembly Line
- **Building 2** : Operation Office / R&D / Test Line
- **Building 3** : HQ / Storage Product Line
- **Building 4** : Package Assembly Line
- **Site Area** : 46,291 m²

From	To	Distance	Time
In-Cheon AirPort	STS 1 st Plant	135 km	90 min
STS 1 st Plant	STS 2 nd Plant	4 km	5 min

组织结构 - SSK



- Finance
- Purchasing
- HR
- IT
- Biz.Planning

- Engineering
- R & D
- Design

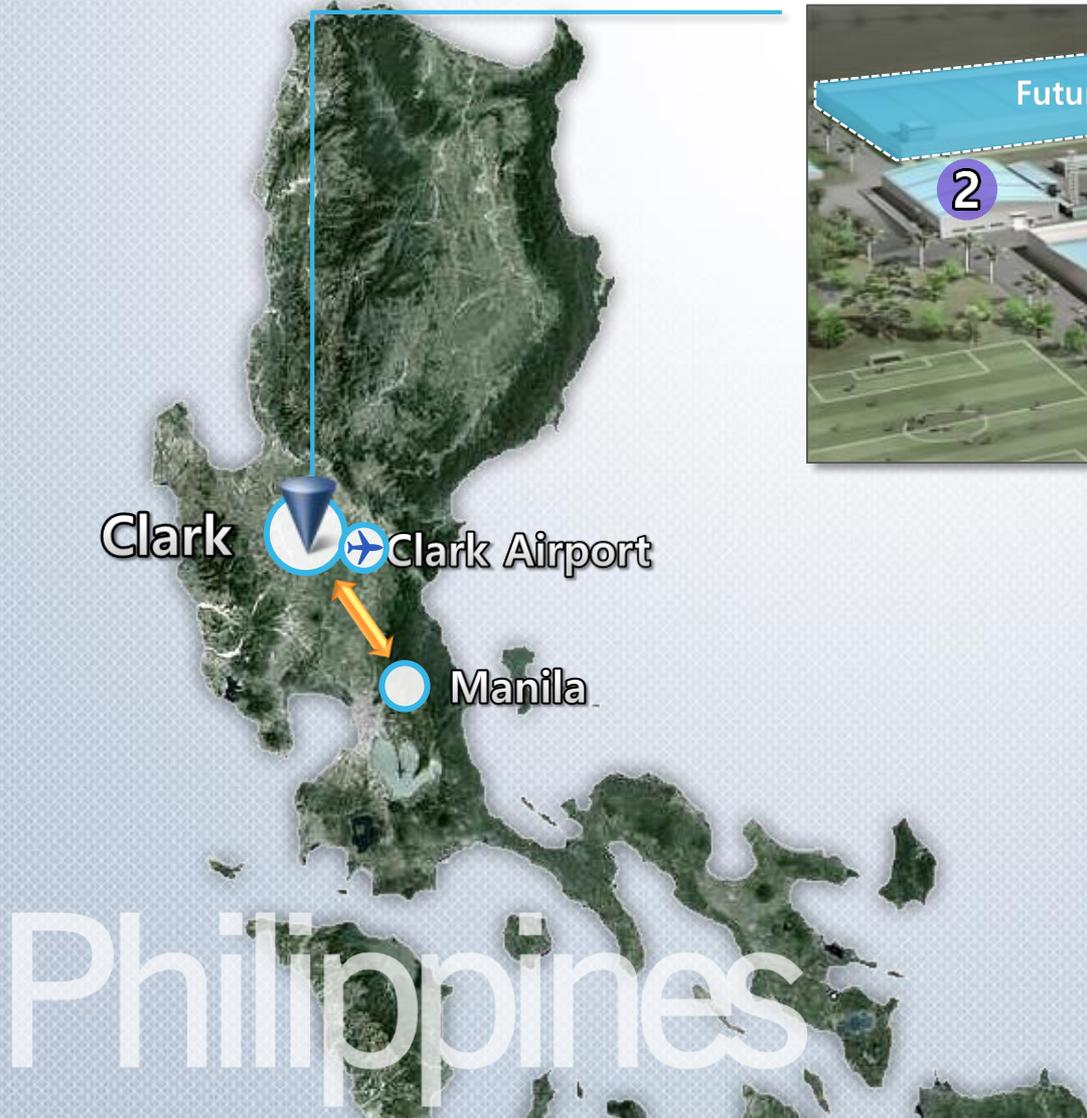
- MFG
- Utility
- Bumping
- PCS

- QA & QC

- MKT 1(Korea)
- MKT 2(Global)



公司概况 - SSP 회사



Plant Information

- **Location** : Clark Freeport Zone, Philippines
- **Capital** : US\$ 40Million
- **Building 1** : IC Packaging & Test Line
- **Building 2** : Material Warehouse
- **Building 3** : Utility Facilities
- **Existing Site Area** : 146,300m²
- **Floor Space Area** : 29,700m²

From	To	Distance	Time
Manila	Clark	114 km	90 min
Clark Airport	Plant	5 km	5 min

盛帆半导体（苏州）有限公司

- 1号楼 : 生产线 / 办公区域
- 2号楼 : 员工宿舍
- 3号楼 : 餐厅 / 培训中心
- 成立时间: 2004年03月
- 占地面积: 66,222 平方米 (待建: 28,772平方米)
- 公司地址: 中国吴江区经济开发区江兴东路288号

上海虹桥机场

距离: 75公里

车程: 45分钟

上海浦东机场

距离: 125公里

车程: 90分钟

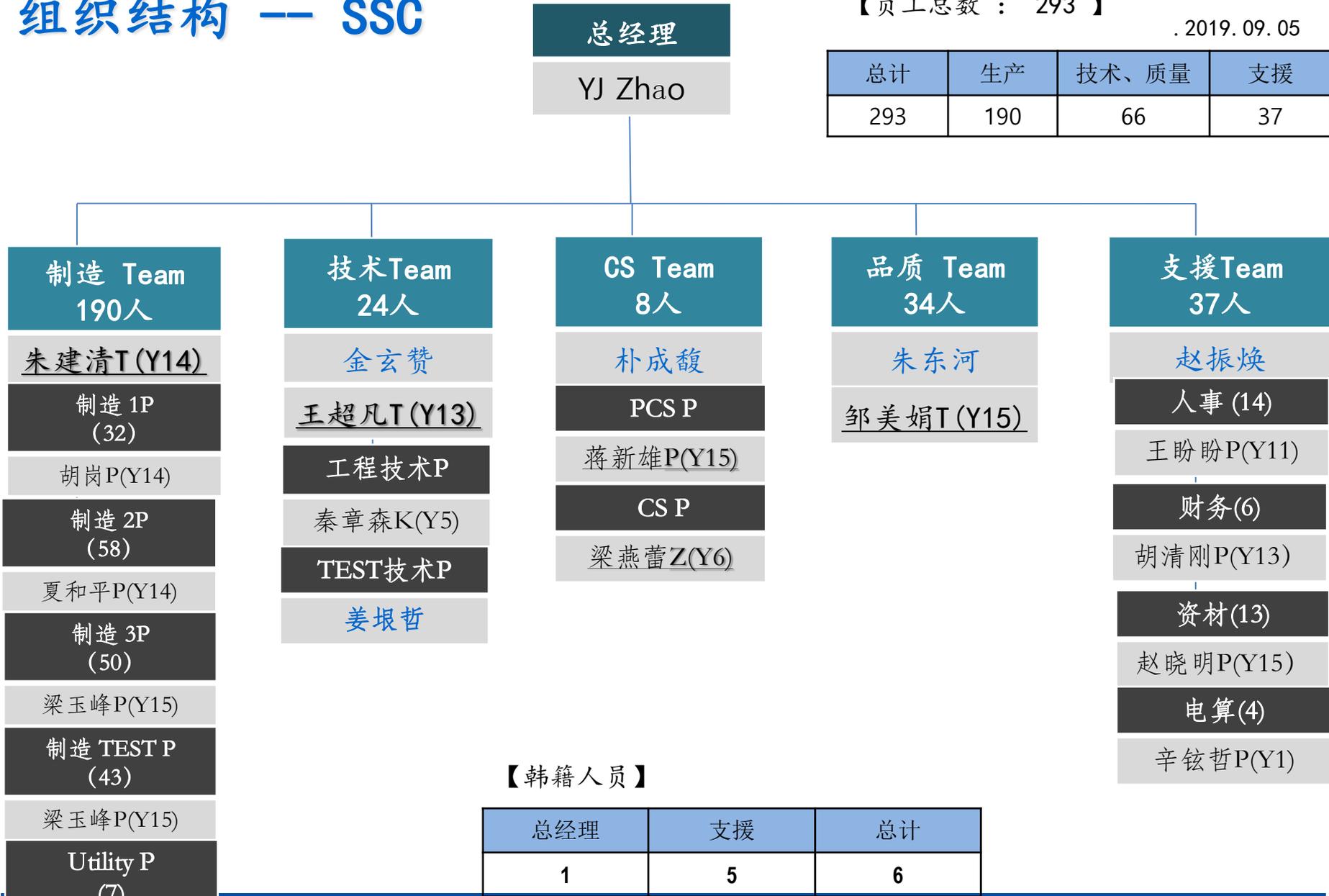


组织结构 -- SSC

【员工总数： 293】

. 2019. 09. 05

总计	生产	技术、质量	支援
293	190	66	37



【韩籍人员】

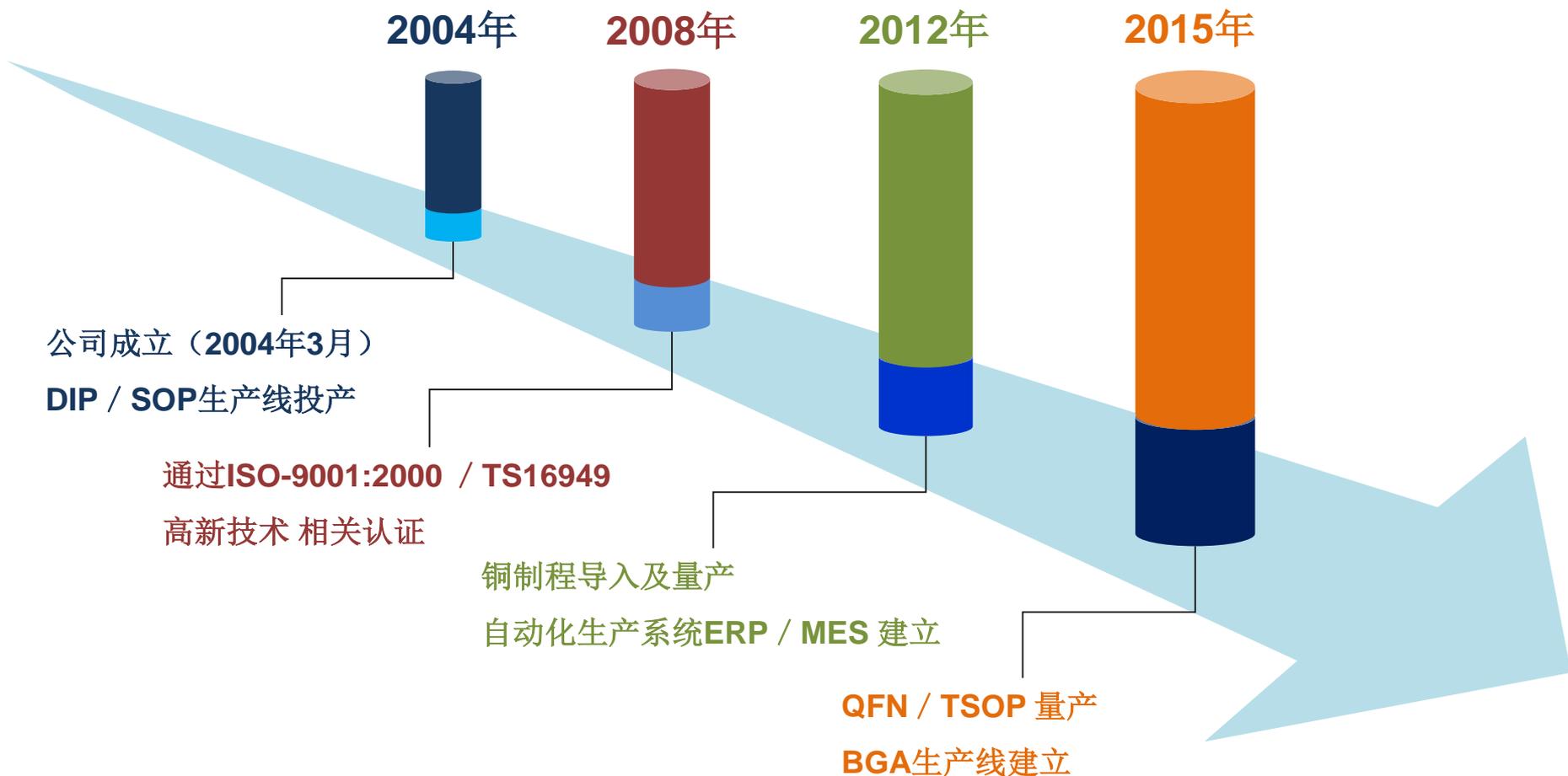
总经理	支援	总计
1	5	6

刘仁志 P(Y13)

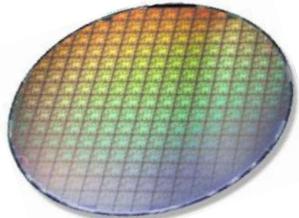
에프에이

客户至上 争做主人 行事如电

发展历程



服务项目



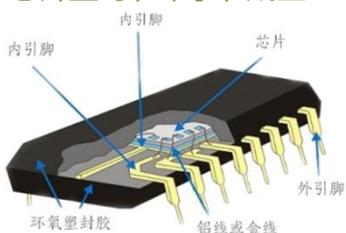
提供专业的IC封装测试解决方案



系统 / 原材料准备
来料通关、检查
生产计划及投入



芯片准备 (研磨 / 切割)
贴片 / 键合 (金 / 铜 / 铝线)
芯片塑封 / 印字 / 成型



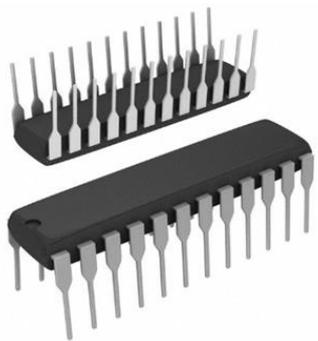
直 / 交流测试
参数测试
功能测试



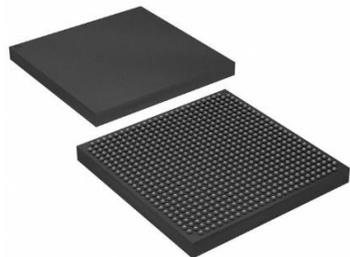
半成品 / 全制品出库
最终检查, 包装
出库资料生成



产品目录



双列直插式封装
Dual In-line Package



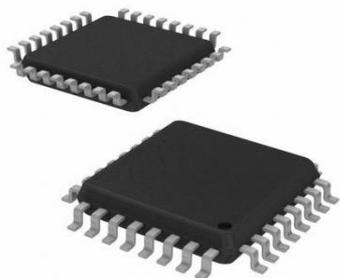
细间距球栅阵列
Fine-Pitch Ball Grid Array



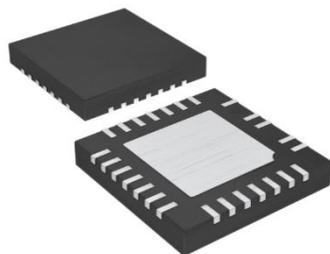
小外形封装
Small Out-Line Package



功能器件
Transistor Out-line



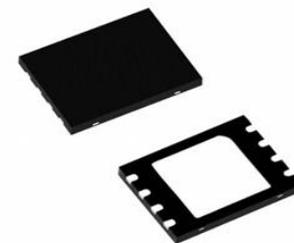
四面扁平封装
Quad Flat Package



方形扁平无引脚封装
Quad Flat No-lead



双侧扁平无引脚封装
Dual Flat No-lead



双侧扁平无引脚（存储）
WSON (Flash IC)

Capacity Status

◆ Machine Status

Process	TOTAL	Back Grind	SAW	D/A	W/B	M/D	M/K	T/F	TEST
SET	635	1	10	60	386	44	13	52	69

◆ CAPA Status

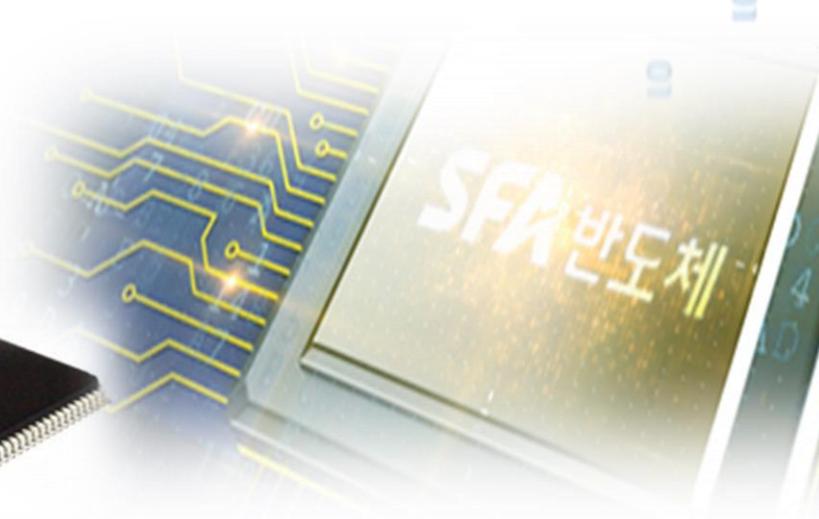
(UNIT: KP/MONTH)

PACKAGE		CAPA	PACKAGE		CAPA
SOP	7/8/14/15/16	24,000	QFP	64/80/100/128/160/208/240/256	2,800
SOP	20/24/26/28/32	15,000	QFN	8/10/16/18/20/24/28/32/36/37/40/42/44/48/50/56/60/64/76/88	12,000
SSOP	10/20/24/28/30	2,300	DFN	8	25,000
TSSOP	14/28/48	8,000	DIP	8/20	5,200
MSOP	8/10	10,000	ADIP	12	0
VQFP	34/128	5,000	SDIP	24	0
LTQFP	48/64/80/100 /128/144/160/176/208/216/256	10,500	TO-220F	3	8,000

Total
116M

质量方针

我们的质量方针是基于有竞争力的成本，运用高效的质量体系，提供最好的产品及服务，以满足客户的要求和期望。



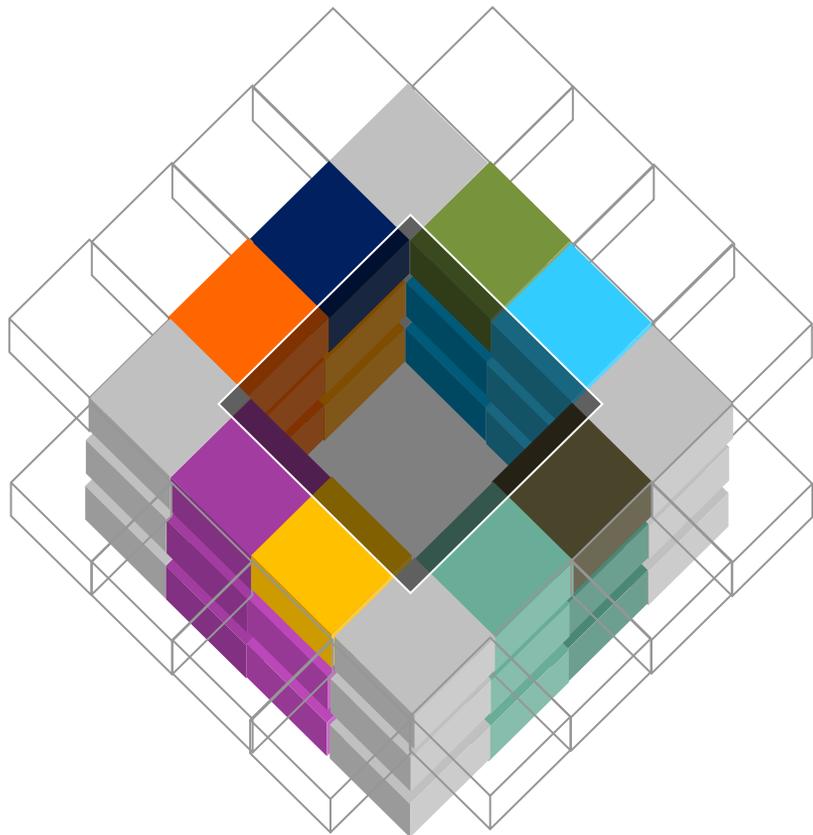
ISO 14001
TS16949
OHSAS18001

SONY Green-Partner

SEC Eco-Partner



产品研发流程



框架、基板设计
Lead frame, Substrate Design

周期 (TAT) : 5 天 (D)

框架、基板交付
Lead frame, Substrate Delivery

周期 (TAT) : 4周 (W)

工程样品封装
Engineer Sample Assembly

周期 (TAT) : 1周 (W)

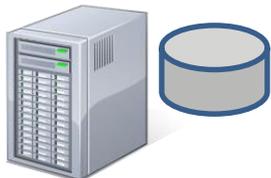
*注: 紧急产品3~5天

信赖性测试
Reliability Test (MSL1&MSL3)

周期 (TAT) : 2周 (W)

自动化生产管理系统

MDM(数据库)



- 产品信息
- 材料清单/用量
- 机器信息
- 机器参数信息
- 作业规范
- 良率
- 工作流程 等

Glomis (MES) / QRP(质量)



- Lot 在工 / 记录
- 材料在工/ 记录 / 检查
- 质量控制 (良率/作业时间/CCS 等)
- 塑封 / 冲模 治具管理
- 机器认证 等

中间设备 (Tib/Rv)

机器控制

- 机器状态报告 (运行、待料、停机)
- 机器事件、报警报告
- 机器参数检查
- 机器自动锁定
- 机器程序上传、下载
- 生产批次追踪
- 芯片Map自动导入

作业&监控

Glomis OI



材料产品信息扫描

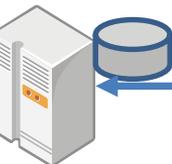


FMB



- 材料批次追踪
- 材料清单、用量控制
- 材料寿命控制
- 塑封、冲模治具控制

- 机器状态实时监控 (运行、待料、停机)
- 材料信息等



Lot Card SCAN

• Lot No.



MC31 SECS/GEM



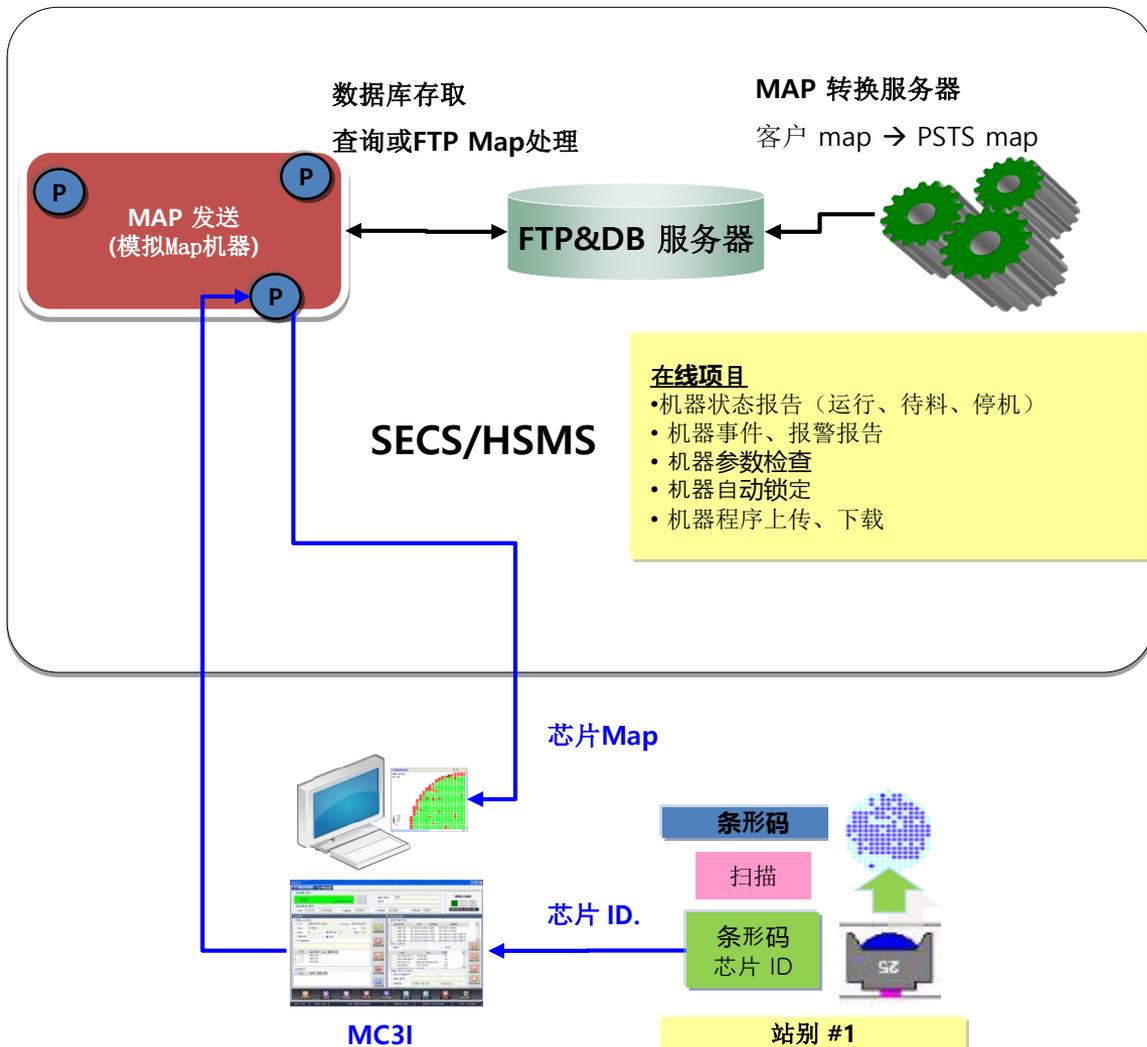
M/C

◆ 仅使用于封装产线1课

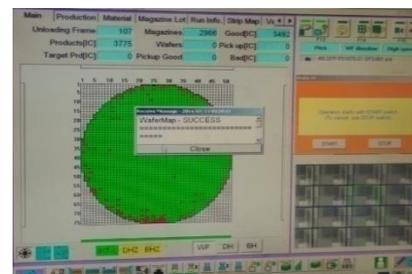
◆ 使用于整个封装产线

自动化生产管理系统

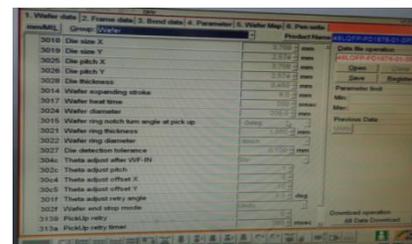
■ 贴片机 (SPA-300/400)



① 扫描芯片条形码

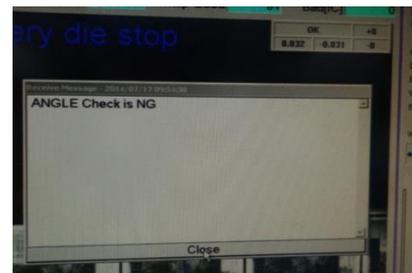


② 下载芯片Map



③ 人工参数检查

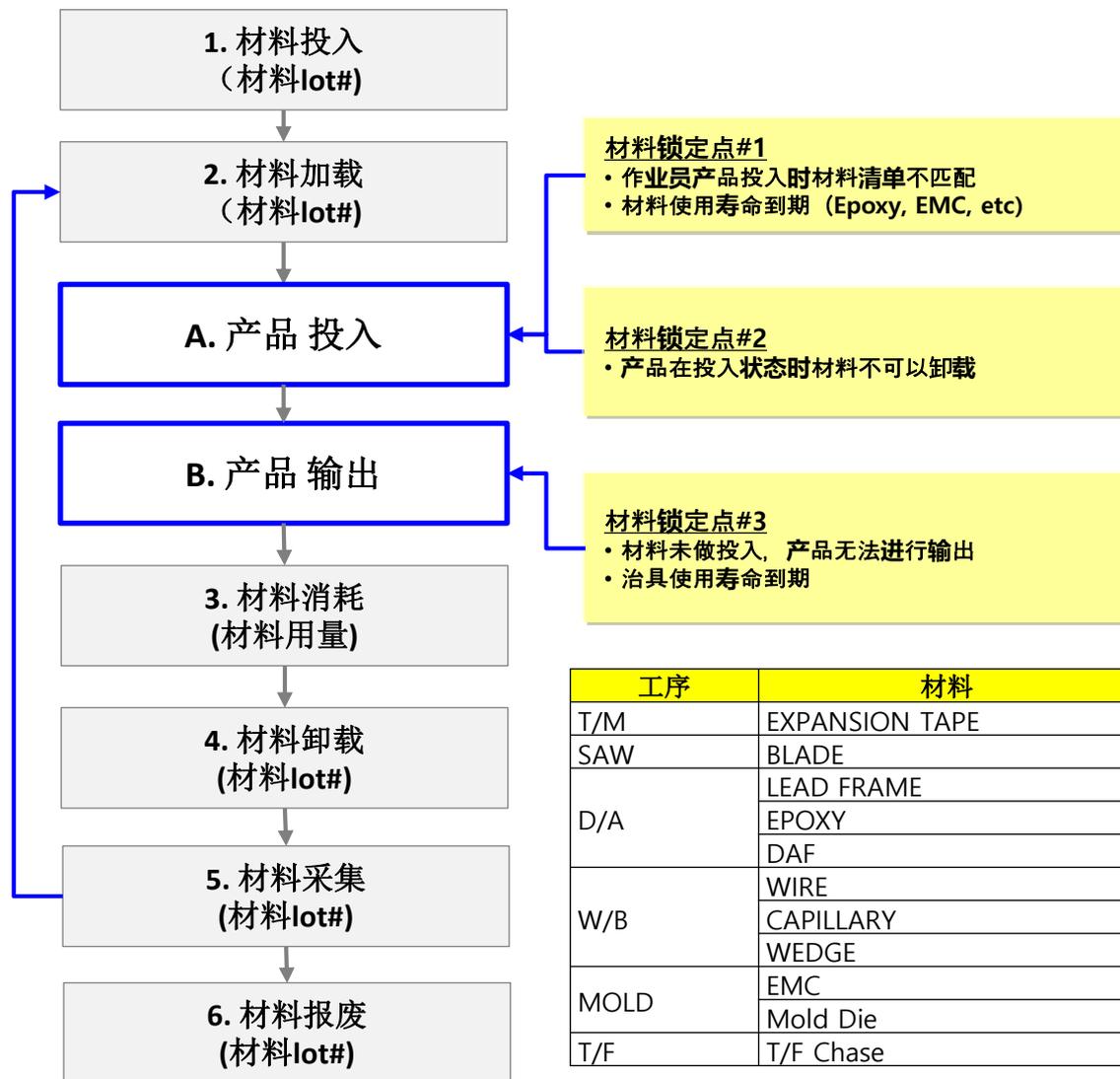
- 检查内容**
- 顶针高度
 - BOND力量
 - BOND热量
 - BOND_TIME速度
 - D/A 角度等



④ 机器锁定
-> D/A 角度

自动化生产管理系统

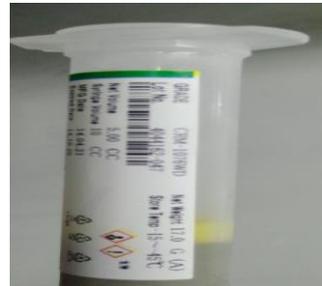
■ 材料 (治具) 的 发货与锁定 (封装产线)



■ 材料加载举例



DA工序LF加载



DA工序Epoxy加载



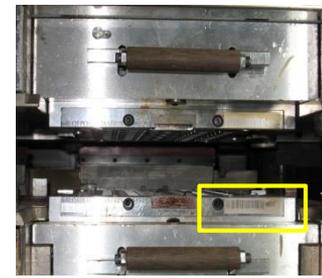
WB工序Wire加载



WB工序劈刀加载



MD工序EMC加载



MD工序治具加载

自动化生产管理系统

FMB Client - 1L1F - WB_ALL

1L1F

Search Condition: Line: 1L1F, Page: WB_ALL, Type: ALL, Model: ALL, Customer: ALL, Package: ALL, Part No: , Eqp ID: , CLEAR, SEARCH

Status Summary: NORMAL MODE

Run	Material Lack	Lot Change	BM	PM	QA Maint
141	13	202	12	0	1
Engineer	MDC	Utility	非效率设备	闲置设备	
1	11	0	2	0	

Utilization: ALL(Cu) Enable(Cu) 383(130) 143(56), Disable(Cu) RUN(Cu) 240(74) 37.3(43.1)%

Total Summary | Online Summary | WB ALL

25 %

Information Material: CAPILLARY, 1021882 / 30EF-WJ, WIRE, A005-C00001 / G/W 0.8MIL Pd ALLOY

EQP ID: WB1903
 EQP Type: MAIN
 Model ID: MAXUM
 Maker ID: K&S
 EQP State: DOWN
 Detail State: BM(5200)
 Control State: OffLine
 Package : 128QFP-2828(AN)
 Part No: S3FC40DXZZ-QA8D-6FJEAD
 LOT No: 60YHU6T
 LOT In Time: 2014-07-16 08:19:10
 WB1903
 Sub Machine List: WB1904
 AcceptFlag: Y
 Seq:
 Customer: SEC
 Last EventTime: 2014/7/16 9:21:16

9:48
2014/7/16

主要客户



大规模集成电路

QFP/SOP/DIP



功率器件

DFN/SOP/QFP/TO



复合信号

TQFP/DIP/QFN



LCD产品

MSOP/TSOP/QFN



微程序处理器

SOP



大规模集成电路

64QFP /48TQFP



模拟装置

SOP/TO



LED/LCD 产品

QFP/SOP/DIP



微程序处理器

SOP/QFP



音频声频器件

QFN

